

# AP720G

自动编程系统

## 更高性能的新一代四吸嘴烧录系统

### 每小时产量3000颗



四支吸嘴

#### 产品特征

- 可达最大化产出的四吸嘴设计
- UPH 3000 适用于大批量生产
- 灵活的出料方式Tray /Tape /Tube均可支持
- 配备SG8000 通用烧录器 · 最大可支持32个IC同时烧录 · 支持烧录的IC类型有EEPROM, NOR, Nand, MCU, CPLD, FBGA, eMMC, UFS等
- 简易便捷的校正方式可最大化减少换线时间
- 可选配Laser Marking, 2D/3D 检测模组
- 一站式操作

# ● System General 能达到最优产出的 四支吸嘴同步架构



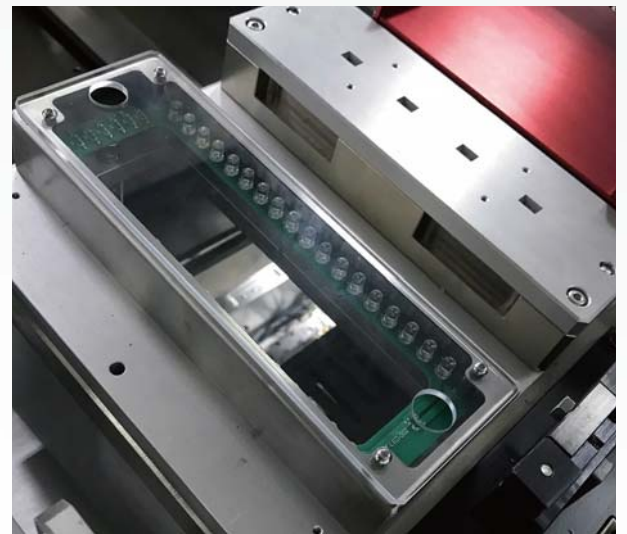
为达最优的UPH，配合四吸嘴的同步架构；  
AP720G软件更新了System General Gang4 &  
Gang8 烧录座和配备了4组上照式CCD

## 先进的四吸嘴设计

为达到3000UPH，AP720G设计四吸嘴同步取放。  
随着半导体工业不断向更小，更薄方向发展  
System General 也持续研发出了新一代的吸嘴设计。  
在AP720G上，每个吸嘴有独立的真空/气流  
控制和取放调节。机械手臂能非常精准，稳定的同  
时取放4颗IC。

## 高精度多视觉校准和最小定位识别

AP720G为精准取放配备了多台上照镜头。搭配  
SG8000 Gang4 and Gang8系列SKB。  
其高效的校准机构能有助于减少每个烧录周期的校  
准时长。



## 可选机械校正块

同时校正4颗IC 的取放偏差。当使用带4个Socket 的  
SKB时，校正块能有效减少校正时间。

## 一站式作业的自动烧录解决方案

AP720G 设计了一站式烧录平台，整合了烧录任务和最小的人机调整。该机型标准配置了Tray to Tray 自动进出料机构。增加了包括Tape、Tube、Laser Marking，贴标签等可选配件接口。AP720G Tray 机构能进行BGA、QFP、TSOP 以及其他多种尺寸封装Tray 盘搬运。一个循环最大可搬运20 Tray



## 灵活的Socket board设计方式 可最大化你的烧录产出

System General 发布了新一代的单烧录座适配器和Gang 8系列适配器。旨在将开发算法时间缩短到50%。提高了SPI、NOR、NAND MCU 在Gang适配器使用灵活性，为开发算法提供了一个灵活的烧录结构，同时为客户提供一个实惠的解决方案。烧录产出最大可提高8倍。



## 通用烧录器

新一代的SG8000烧录器是通用烧录器，它能支持SPI、NOR、NAND、eMMC、MCP、PLD、CPLD、FPGA、UFS等。不仅能满足生产线高效率需求，而且也可适做用研发工具。Nand/eMMC/UFS 文档管理工具能集成多个配置需求和寄存器设定。SG8000烧录平台还提供系统报告。通过报告能帮忙用户监测烧录良率，跟踪设备性能，管理故障原因分析。SG8000也可为客户化MES提供多种应用程序接口。



SG8000 通用烧录器

# AP720G

Automated Programming System

## Specifications

### • 机台规格 •

- ▶ 每小时产量：3000 UPH (0 烧录时长)
- ▶ 放置精度：±0.02mm
- ▶ 放置重现度：±0.02mm
- ▶ 放置力度：95克
- ▶ 取放方式：四支真空吸嘴
- ▶ 机台尺寸：1210 (长)x1310 (宽)x1500 (高) mm
- ▶ 包装尺寸：1920 (长)x1470 (宽)x1900 (高) mm
- ▶ 净重量：700公斤
- ▶ 包装后重量：750公斤

### • 定位系统 •

- ▶ X-Y轴驱动系统：伺服马达驱动
- ▶ X轴精度：0.001mm
- ▶ Y轴精度：0.001mm
- ▶ X-Y轴重现度：0.01mm
- ▶ Z轴/Theta轴驱动系统：步进马达驱动
- ▶ Z轴重现度：0.02mm
- ▶ Theta 重现度：0.18度

### • 定位校准系统 •

- ▶ 四吸嘴运行
- ▶ 上照式CCD \*4 (标准配备)130万像素  
FOV：35mm\*35mm
- ▶ 下照式CCD \*1 130万像素  
FOV：35mm\*35mm
- ▶ 机械校正块

### • 编程系统 •

- ▶ 编程模块：8台SG8000 通用烧录器
- ▶ 编程socket：可支持64颗eMMC 和 MCU/Memory 同时烧录
- ▶ 支持的芯片种类：EPROM · EEPROM · Flash, Microcontroller, PLD, CPLD, FPGA, MCU, eMMC, UFS
- ▶ 支持封装种类：PLCC, TSOP, TSSOP, TQFP, PQFP, SOIC, SSOP, uBGA, CSP及其它

### • 系统软件 •

- ▶ 用户接口：基于Window系统的HMI
- ▶ 操作系统：Windows 10

### • 操作环境要求 •

- ▶ 输入电压：220VAC · 单相 · 3线
- ▶ 输入行频：50/60Hz
- ▶ 功耗：2.0KVA
- ▶ 气压：0.4Mps~0.5Mpa
- ▶ 气流：50 liters/min
- ▶ 操作温度范围：15~30°C ( 59~86°F )
- ▶ 相对湿度：35%-90%

### • 选配系统 •

- ▶ 盘装进/出料机构
- ▶ 卷带装进/出
- ▶ 管装进/出
- ▶ 打点机构
- ▶ 标签飞达
- ▶ 激光打标机